

EBE • ETX-Baseboard Euroformat für 19“-Systeme 3HE/4TE



■ Wechselbare ETX-Module mit steckbarem Arbeitsspeicher

AMS GEODE LX800 433MHz; 256MB; SVGA-Grafik; ETH 10/100; CF
VIA EDEN 400MHz; 512MB; SXGA-Grafik; Ethernet 10/100Mbit;
INTEL Celeron 400/650MHz; 256MB; XGA-Grafik; ETH; 2xUSB;
INTEL Celeron M 600MHz/1GHz; 256MB; XGA-Grafik; ETH; 2xUSB;
INTEL Pentium III; 500-933MHz; 512MB; XGA-Grafik, Ethernet,
INTEL Pentium M 1,1GHz low power (entspr. P IV, 2,7 GHz) 1GB;

■ Schnittstellen

Kartenfront: ETH RJ45; COM1 RS232; VGA-XGA; KEY/Maus PS/2;
Pfostenverbinder: COM2-4 RS232, COM2 TTL optional; LPT; 4xUSB,
FDD; IDE ATA; TFT mit TTL, optional LVDS; I²C-Bus; CF-Sockel u.
Li-Ion-Batterie bestückt. Optional: SPEAKER, AUDIO, RESET.
ISA-Bus: VG-Leiste abgewinkelt für ISA/AT96; senkrechte Bestückung für
Euroboard-Sandwich; ohne VG-Leiste, dann mit ext. POWER.

■ Komponenten onboard bestückbar

Widerstands-Netzwerke: Anpassung TFT-Interface Kontron/Advantech
ETX-Modul mit Heatspreader und Kühlkörper nach Bedarf.
CompactFlash: Karte 32MB bis 2GB nach Wahl.

■ Mechanische Spezifikation

Maße 100x160mm, Höhe je nach bestückten Komponenten ca. 40mm
ohne Display; Leiterplattendicke 1,5mm, alle Steckverbinder indirekt in
Industriequalität (Markenware). Frontplatten und Kabelsätze verfügbar.

■ Umwelt-Spezifikation

Betriebstemperatur 0...60°C; Lagertemperatur -20 ... +80°C;
Rel. Luftfeuchte Betrieb/Lagerung: 10%-90% ohne Kondensation,
Betriebshöhe: -300m...+3000m; Schock und Vibration gem. IEC1131,
EMV nach EN60950; Sicherheit nach IEC60950, DIN EN60950 und
UL60950. EMC nach VDE-EMV.

■ Software-Unterstützung

Windows 2000 / XP, XP Embedded; weitere in Vorbereitung.

■ HIGHLIGHTS

■ Rechnerleistung mit
wechselbarem ETX-
CPU-Board skalierbar

■ Peripherieausstattung
nach Bedarf wählen:
- nur so viel wie nötig -

■ Verkabelung entfällt
weitestgehend, daher
hohe Betriebssicherheit

■ Hohe Produktionszahlen
von ETX- u. Baseboard
sichern günstige Preise

■ Reagieren auf steigende
Leistungsanforderungen
ohne Redesign möglich

■ Entwicklungsaufwand
nur für Sondergehäuse,
Standardgehäuse a. A.

■ Schnellster Markteintritt
bei kleinstem Aufwand
und Risiko.

OUTSOURCING der IPC-Hardware:

die bessere Alternative
zum Selbermachen !

■ **M A S S GmbH**
An der Rosenhelle 4
D-61183 Niederdorfelden
Tel.: +49(0)6101/4076-0
Fax: +49(0)6101/4076-20
e-mail : info@mass.de
URL : www.mass.de